



平成29年5月26日

各 位

会社名 株式会社 M A R U W A
代表者 代表取締役社長 神戸 誠
(コード番号 5344 東証・名証第1部)
問合せ先 管理本部長 及位 環
(TEL 0561-51-0839)

株式会社日立パワーデバイスの会社分割（簡易吸収分割）による
事業承継に関するお知らせ

当社は、平成29年5月26日開催の取締役会において、株式会社日立パワーデバイス（以下、「日立パワーデバイス」といいます。）の一部であるセラミック端子事業（以下、「対象事業」といいます。）を会社分割（以下、「本件分割」といいます。）の方法により承継することを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 本件の目的

当社は1973年創立以来、永年にわたって培われたセラミック材料技術をベースに電子部品及び電子部品用セラミックのメーカーとしてグローバルに事業を展開してきました。一方、日立パワーデバイスは主力である半導体事業への注力度をより高めたいと考えており、セラミック端子事業については、今後の事業成長のために社外とのアライアンスを検討しておりました。この度、当社は日立パワーデバイスからエネルギー、航空宇宙分野などに強みを持つこの対象事業を引き受けることで、セラミック素材単体からセラミックと金属を強固に接合する気密封じ技術・製品を承継することにより、アプリケーションにより近づいた顧客ニーズに広く貢献することが可能になり、顧客基盤を一層拡大することを目的とし、対象事業を承継することになりました。

2. 本件分割の要旨

(1) 本件分割の日程

取締役会（日立パワーデバイス）	平成29年5月25日
取締役会（当社）	平成29年5月26日
契約締結	平成29年5月26日
効力発生日	平成29年10月1日（予定）
金銭交付日	平成29年9月29日（予定）

(注) 本件分割は、当社においては会社法第796条第2項に定める簡易分割であり、当社の株主総会の承認を得ずに実施いたします。

また、日立パワーデバイスにおいては会社法第784条第2項に定める簡易分割であり、同社の株主総会の承認を得ずに実施いたします。

(2) 本件分割の方式

平成29年10月1日付(予定)で、当社(承継会社)は、日立パワーデバイス(分割会社)の対象事業を会社分割(簡易吸収分割)の手法により譲り受けます。

(3) 本件分割に係る割当ての内容

本件分割に際して、当社より日立パワーデバイスに対して現金100百万円が交付される予定です。

(4) 本件分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(5) 本件分割により増加する資本金

本件分割による当社資本金の増加はありません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

当社は、本件分割により対象事業に関する資産、負債及びこれらに付随する権利義務等の一部を承継します。

(7) 債務履行の見込み

本件分割の効力発生日以後に弁済期が到来する承継会社の債務について、履行の見込みに問題はないものと判断しております。

3. 本件分割に係る割当ての内容の根拠等

(1) 割当ての内容の根拠及び理由

当社は分割される対象事業について、平成28年9月に概算で算出された資産、負債を元に純資産価額方式を参考に割当額を算定しました。その際デューデリジェンスを行い、対象事業の状況及び将来の見通し等を総合的に勘案した結果、最終的に「2. 本件分割の要旨」の「(3) 本件分割に係る割当ての内容」に記載の内容が妥当であるとの判断に至り、本件分割契約を締結しました。

(2) 算定に関する事項

① 算定機関の名称ならびに当社及び日立パワーデバイスとの関係

本件分割の対価の算定にあたって第三者による算定は実施しておりません。

② 算定の概要

該当事項はありません。

(3) 上場廃止となる見込み及びその事由

該当事項はありません。

(4) 公正性を担保するための措置

特段の措置を講じておりません。

(5) 利益相反を回避するための措置

該当事項はありません。

4. 当事会社の概要

	承継会社	分割会社
(1) 名称	株式会社MARUWA	株式会社日立パワーデバイス
(2) 所在地	愛知県尾張旭市南本地ヶ原町 3丁目83番地	茨城県日立市大みか町 5丁目2番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 神戸 誠	代表取締役社長 山崎 龍雄
(4) 事業内容	セラミック部品事業	半導体事業
(5) 資本金	8,647百万円	450百万円
(6) 設立年月日	昭和48年4月5日	平成25年10月1日 (創業：昭和48年2月1日)
(7) 発行済株式数	12,372,000株	450,000株
(8) 決算期	3月末日	3月末日
(9) 従業員数	1,709名	603名
(10) 主要取引先	ローム(株)、パナソニック(株)ほか	Hitachi America, Ltd.、Hitachi Europe Ltd.、Hitachi East Asia Ltd.、(株)日立製作所ほか
(11) 主要取引銀行	三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行	みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行
(12) 大株主及び持株比率 (平成29年3月31日現在)	株式会社神戸アート 28.47% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会 社 11.09%	株式会社日立製作所 100%

	CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY 4.82%					
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3.91%					
	HSBC-FUND SERVICES, SPARX ASSET MANAGEMENT CO LTD 2.90%					
(13) 上場会社と当該会社の関係						
資本関係	該当事項はありません					
人的関係	該当事項はありません					
取引関係	該当事項はありません					
関連当事者への該当状況	該当事項はありません					
(14) 最近3年間の財政状態及び経営成績(承継会社・連結)						
	株式会社MARUWA (承継会社・連結)			株式会社日立パワーデバイス (分割会社)		
	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期	平成 27 年 3 月期	平成 28 年 3 月期	平成 29 年 3 月期
純資産(百万円)	41,000	41,700	43,317	3,859	△4,922	△4,752
総資産(百万円)	49,445	48,550	50,594	19,355	12,105	10,628
1株当たり純資産(円)	3,319.58	3,376.42	3,506.80	8,575.76	△10,938.34	△10,561.93
売上高(百万円)	32,811	30,578	32,187	26,950	24,523	24,564
営業利益(百万円)	2,405	3,812	4,953	△842	△1,782	△1,012
経常利益(百万円)	2,841	3,702	4,978	△557	△1,865	△1,206
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円)	884	2,287	2,850	△287	△8,781	169
1株当たり当期純利益(円)	71.59	185.18	230.76	△638.11	△19,514.11	376.40
1株当たり配当金(円)	36	38	40	-	-	-

5. 承継する事業部門の概要

(1) 承継する部門の事業内容

セラミック端子事業に関する権利義務の一部

(2) 承継する部門の経営成績(平成29年3月期)

売上高 923 百万円

売上総利益 129 百万円

(注)売上高及び売上総利益については、対象事業の数値を概算で算出しております。

(3) 承継する資産、負債の項目および帳簿価格

承継する資産、負債の詳細については平成 29 年 10 月 1 日(予定)付の吸収分割効力発生日後、確定次第開示します。

6. 会計処理の概要

(1) 会計上の分類

取得

(2) のれん

のれんに与える影響額は軽微であります。

7. 本件分割後の状況

承継会社である当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期についての変更はありません。

8. 今後の見通し

本件分割が、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。

(参考) 当期連結業績予想(平成 29 年 5 月 8 日公表分)及び前期連結実績 (百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益
当期業績予想 (平成 30 年 3 月期)	33,350	5,400	5,450	3,400
前期実績 (平成 29 年 3 月期)	32,187	4,953	4,978	2,850

以 上